

IEEE International 3D Systems
Integration Conference 2024

(3DIC 2024)

出展マニュアル v7

IEEE International 3D Systems Integration Conference 2024

1. 3DIC開催趣旨

IEEE 3DICは、3次元LSIに関する日本で初めての国際会議として、超先端電子技術開発機構 (ASET)の主催で2007年3月に開催された「3D-SIC2007」から続くもので、2009年より日欧米を毎年持ち回りで開催するIEEEの名を冠した国際会議になりました。回を重ねるごとに内容が充実するとともにその規模が拡大し、名実ともに3D-IC/チップレット・システム集積に関する最も著名な国際会議となっています。今回は、13回目の開催であり、世界中の主要な3D-IC/チップレット・システム集積研究者を招待するとともに、国内外から一般口頭講演とポスター発表を募り、参加者全員が実質的な議論ができるように会議を構成しています。3D-IC/チップレット・システム集積の研究には、半導体プロセス、デバイス技術からパッケージ技術、設計、システムアーキテクチャにまで跨がる幅広い知識が必要となるため、専門領域を超えた議論ができる知識技術融合型の本会議を継続的に開催するとともに、若手研究者の積極的な参加を促し、当該分野を代表する国際会議の一つに発展させることを目指しております。

本年9月25日(水)～9月27日(金)に3DIC・システムに関する国際会議であるIEEE International 3D Systems Integration Conference 2024 (3DIC2024)をホテルメトロポリタン仙台(9/25)及び仙台国際ホテル(9/26-27)において開催します。

初日9月25日(水)にはホテルメトロポリタン仙台で、13時から講演、18時からレセプションを行います。初日はMediaTechからモバイルAI半導体、IBMからNuromorphic Chip「NorthPole」などのKeynoteに加え、BSPDNやハイブリッド接合に関する招待講演が行われます。二日目と三日目には仙台国際ホテルで、朝8時50分から講演(ポスターや企業展示を含む)が行われます。米国NAPMPの活動内容に関するKeynoteが行われ、FOPLPなどの先端半導体パッケージング技術に加え、量子コンピュータや熱設計に関する招待講演が行われます。また、最終日9月27日(金)の午後には東北大学内に完成して本年4月より運用が始まった高輝度大型放射光施設「[NanoTerasu](#)」の見学会を無料で行います。御興味のある方は、お早めに会議参加登録と併せてお申し込みください(先着順)。NanoTerasu website -> <https://nanoterasu.jp/>

2. 企業展示概要

- (1) 名称 IEEE International 3D Systems Integration Conference 2024 (3DIC2024)
組織委員長 田中 徹(東北大学 大学院医工学研究科 教授)
プログラム委員長 福島 誉史(東北大学 大学院工学研究科 准教授)
- (2) 会期 2024年9月25日(水)～9月27日(金)
会議: 2024年9月25日(水)～9月27日(金)
展示会: 2024年9月26日(木)～9月27日(金)
- (3) 会場 9月26日(木)と9月27日(金) 仙台国際ホテル
電話 022-268-1111
住所 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1
アクセス: <https://www.tobu-skh.co.jp/hotel/access/>
注: 9月25日(水)の会議は、[ホテルメトロポリタン仙台](#)で開催されます。
JR仙台駅より徒歩5分
地下鉄仙台駅南2出口より徒歩4分
- (4) 日程
搬入・設置 9月26日(木)
主催者工事 9月26日(木) 07:00～09:00
出展者設営 9月26日(木) 09:00～10:20
展示時間 9月26日(木) 10:20～17:50
9月27日(金) 08:30～10:20
搬出・撤去 9月27日(金) 10:20～11:20
- (5) 参加人数 約150名予定

3. 大会スケジュール at-a-glance

3DIC 2024 Program at-a-glance								
September 25-27, 2024								as of August 20, 2024
Conference Venue:								
September 25, 2024 at Hotel Metropolitan Sendai								
September 26-27, 2024 at Sendai Kokusai Hotel								
Date	25-Sep		26-Sep		27-Sep			Date
Venue	Hotel Metropolitan Sendai		Sendai Kokusai Hotel		Sendai Kokusai Hotel		NanoTerasu	Venue
Room	Sendai-East	Sendai-West/South	Heian	Heian & Foyer	Heian	Heian & Foyer	NanoTerasu Visit	Room
9:00			Registration (8:20-)	Preparation for exhibition and poster session (9:00-10:20)	Registration (8:20-)	Preparation		9:00
			Keynote Talk III (8:50-9:30)			Session 5: Quantum Technology (8:50-10:00)	Exhibition (8:30-10:20)	
10:00			Session 2: Process Technology for Hybrid Bonidng (9:30-11:45)	Poster & Exhibition (10:00-17:50)	Coffee Break (10:00-10:15)			
			Coffee Break (10:30-10:45)			Session 6 : Bumpless and Hybrid Bonding Technology (10:15-11:55)	Dismantle by exhibitors (10:20-11:20)	
11:00			Session 2: Process Technology for Hybrid Bonidng (9:30-11:45)					Dismantle by organizer (11:20-13:00)
12:00	Registration (12:00-)		Lunch Time (11:45-13:00)			Award Ceremony & Closing Remarks (11:55-12:10)		
13:00	Opening Remark (13:00-13:10)			Poster Session Core Time (13:00-14:30)				
	Keynote Talk I (13:10-13:50)							
14:00	Keynote Talk II (13:50-14:30)						NanoTerasu Visit (in Japanese) 14:00-15:00	14:00
	Coffee Break (14:30-14:45)		Panel Session (14:30-15:15)					
15:00	Invited Talk I (14:45-15:15)		Coffee Break (15:15-15:30)				NanoTerasu Visit (in English) 15:00-16:00	15:00
	Invited Talk II (15:15-15:45)		Session 3: Advanced Interposers (15:30-17:00)					
16:00	Invited Talk III (15:45-16:15)		Coffee Break (17:00-17:10)					16:00
	Session 1 : Quantum Technology (15:55-17:25)		Session 4: Application (17:10-17:40)					
17:00								17:00
18:00								18:00
19:00		Banquet (18:00-20:00)						19:00
20:00								20:00
21:00								21:00

4. 展示スケジュール

展示開催場所： 仙台国際ホテル

展示開催時間： 9月26日（木）10:30～17:50

9月27日（金）08:30～10:20

出展者様搬入時間：9月26日（木）09:00～10:20

出展者様搬出時間：9月27日（金）10:20～11:20

3DIC 2024

9月25日（水）13:00～17:25 Opening、講演セッション

18:00～20:00 バンケット

仙台メトロポリタンホテル

9月26日（木）08:50～17:40 講演セッション、技術展示、ポスターセッション

9月27日（金）08:50～12:10 講演セッション、Award Ceremony、技術展示

仙台国際ホテル

9月27日（金）14:00～16:00 [NanoTerace見学](#)（オプション）前半日本語、後半英語

5. 企業展示について

(1) 出展対象 ・装置、材料、加工技術、解析技術、受託加工他

(2) 出展料金

種類	単位	小間サイズ	場所	出展料金 (税別)
基礎小間	1 小間	W1, 800mm×D900mm ×H2, 100mm	展示会場	150,000 円

(3) 募集小間数 30小間

(4) 展示小間割の決定 事務局にて決定いたします。

(5) 出展物 出展対象に記載された範囲のもの、及び当方の認めたものとします。

(6) 出展料のお支払いについて

お申込み締め切り後、事務局より請求書をお送りいたしますので、期日までに指定口座（請求書に記載）にお振込み下さい。

(7) 出展受付の〆切・キャンセルについて

出展受付の〆切は2024年7月26日（金）とさせていただきます。8月24日（土）以降のキャンセルについては、一切お受けできません。キャンセルの場合は 100%キャンセル料が発生いたしますので、予めご了承下さい。

(8) 電気

出展企業の希望により、有償で電気（交流単相二線式 100V50Hz）を開閉器にて小間まで供給します。それ以外の特殊電源に関しては別途ご相談下さい。

電源の供給時間： 9月25日（木）09:00～18:00

9月26日（金）08:00～11:00

(9) 禁止事項

装飾物、展示物の高さは、2.1m に制限します。ただし、やむを得ず超える場合は運営事務局の承認を必要とします。また、水、プロパンガス、圧縮空気の使用、床面および壁面への直接工作（ゴムテープ、アンカー等）、現金と引き換えに出展物を引き渡すことは原則的に禁止します。但し、当方の認めたものは、限定的に許可する場合があります。

(10) 外国出展物

展示場は、保税展示場にはしません。海外からの出展物は、国内貨物として出展するか、または ATA カルネの制度をご利用下さい。詳細は、運営事務局にお問い合わせ下さい。

(11) 出展企業へのご案内 開催の1ヶ月前までに小間割、搬入、装飾、管理等について詳細をご連絡いたし

ます。什器・照明器具等のリースにつきましてもこの時に併せてご案内いたします。

- (12) 会場の管理
会場及び出展物の保全については、最善の保護と管理にあたりますが、天災その他の不可抗力による事故、盗難、紛失、及び小間内における人的被害の発生については責任を負いません。
- (13) 会期・開場時間・開催場所の変更
やむを得ない事情により会期・開場時間・開催場所を変更する場合があります。この変更を理由として出展申込を取り消すことは出来ません。また、これによって生じた損害は補償しません。
- (14) 本会議への参加資格について
- (15) 出展企業に対しては **1 小間あたり 2 名まで講演会場へ入って聴講が可能です**。なお、展示会場内への入場制限はございません。出展企業にはオンラインの参加登録URLをご担当者様に別途ご案内しておりますのでご登録ください。
なお、無料枠2名は、9月25日(水)にホテルメトロポリタン仙台で開催される講演セッションの聴講も可能ですが、**同日のバンケットへの参加には別料金が必要です**。
なお、仙台国際ホテル周辺に飲食店はございますので、お弁当は準備いたしません。
- (16) プログラム・抄録集について
出展企業には、IEEE International 3D Systems Integration Conference 2024 のプログラム・抄録集を1部無償で提供いたします。
- (17) 展示物の送付先
宅急便を展示会場に直接発送する場合には、届け先欄に必ず会社名を明記してください。9月25日(水)会場必着にてお送りください。お荷物の受取にお立合いいただく必要はありません。届いた荷物は、事務局にて、出展ブース前に置いておきます。

送付先：

仙台国際ホテル 宴会気付け 9/26-27 3DIC2024
出展企業名〇〇〇〇 **(必ず出展企業名を記載してください)**
TEL: 022-268-1111
住所 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1

会場から宅急便を発送する場合は、受付にて送り状(ヤマト運輸着払いのみ)を用意しますのでご利用下さい。お荷物については、当日所定の場所をお知らせいたします。伝票もご用意いたします。
(着払いのみ)事務局で承るお荷物の発送は、お立合いいただく必要はありません。

お車での搬入をご希望の方は、9月26日(木)午前8時30分から10時30分まで承りますので、事務局に車両の種別と台数をお知らせください。事前にスケジュールを調整して、お知らせいたします。

6. 小間仕様

基礎小間(パッケージブース)：1 小間=間口 1,800mm×奥行 450mm×高さ 700mm

・展示台 1 台 (W1,800mm×D450mm×H700mm)

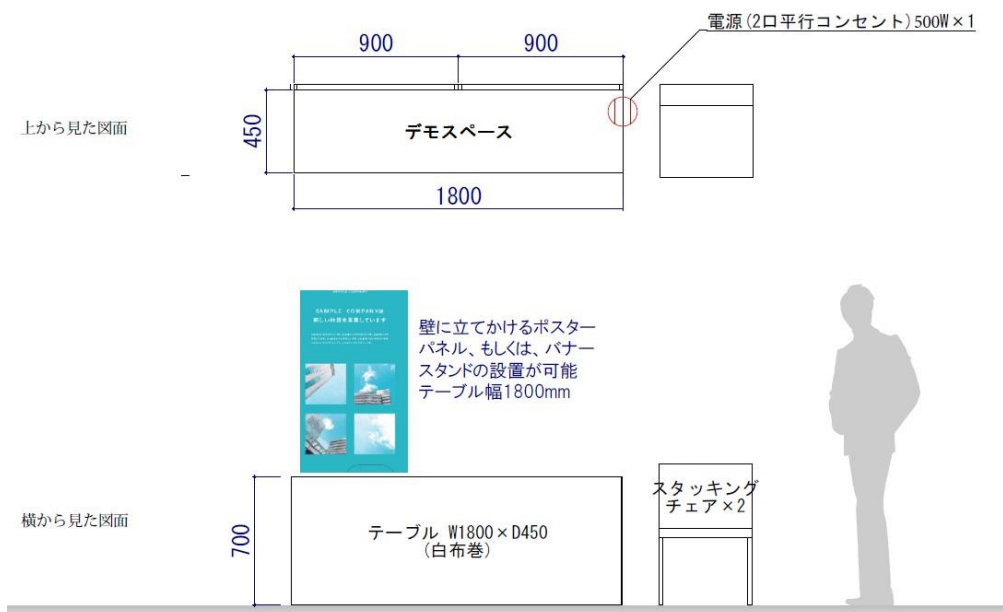
白布付き(但し商品の上にかけるクロスはご持参下さい)

・バックパネル無し(希望があれば有償ですがご用意できます)

・少し斜めにし壁に立てかけるイメージ(クロス貼り、画鋸留め、両面テープ全て不可)

・社名入りスタンド(角ゴシック・黒文字)

・椅子(2脚)



以上のものは運営事務局で設置いたします。

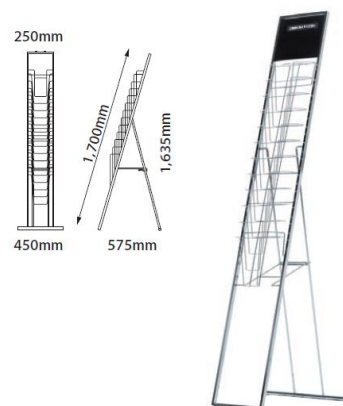
上記以外の小間内装飾は、出展企業が行って下さい。バナーロールのようなものを使って頂いても結構でし、通行の障害にならなければテーブル前にディスプレイを置くなど可能です。

電源、バックパネル等をご希望の方は、9月6日までに事務局にご連絡ください。別途費用にてお承りいたします。

- ・電源コンセント (100V500W) 1個 差込口2口 5,000円 (税別)
- ・バックパネル (W900 x H2100) 1枚 10,000円 (税別)
1小間につき2枚まで設置可能です
- ・カタログスタンド(W250 x D110 x H1700) 7,000円 (税別)

カタログスタンド A4縦サイズ12段

●サイズ: W250×D110×H1,700(mm)



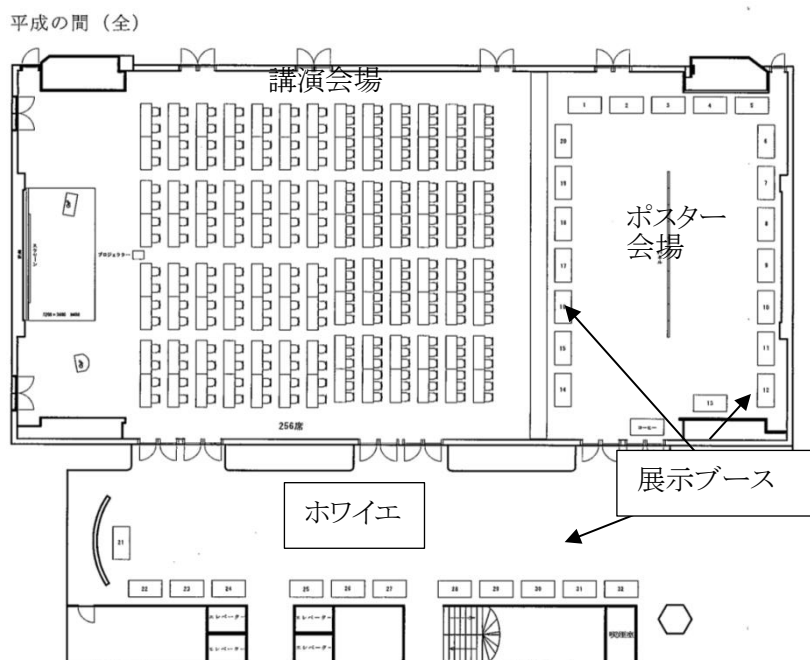
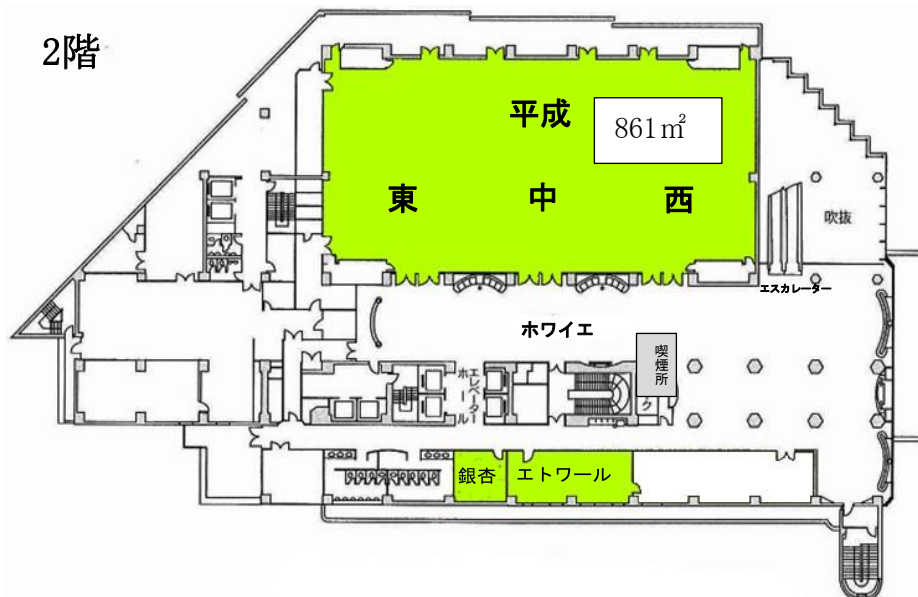
- ・ロールアップバナー
(プリントサイズ W850×H2000～最大H2400mm) ¥38,000 (税別)
遮光特殊スクリーン, 専用ナイロンバッグ付属
納期: 9月6日までに 完全データをご支給ください (.ai、.pdf)
- ・貴名受 ¥3,000 (税別)



7. 出展者様の参加登録とご入場

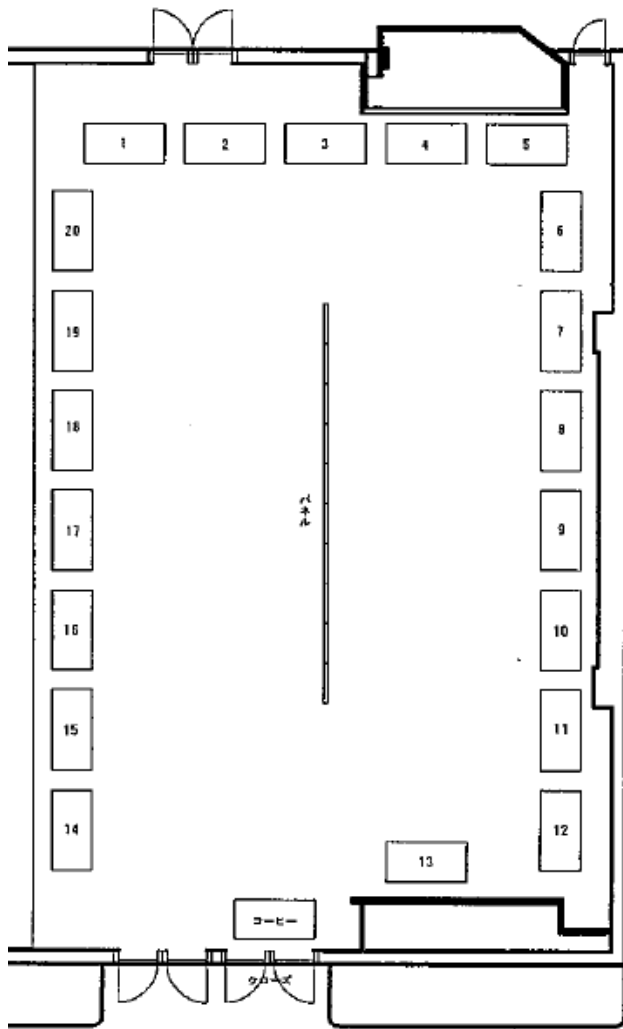
セキュリティの関係で、事前にご登録された方にご入場頂けます。なお、当日受付は、事前もしくは会場で、PCやスマホにてご参加登録をお願い申し上げます。

8. フロアレイアウト (仙台国際ホテル)



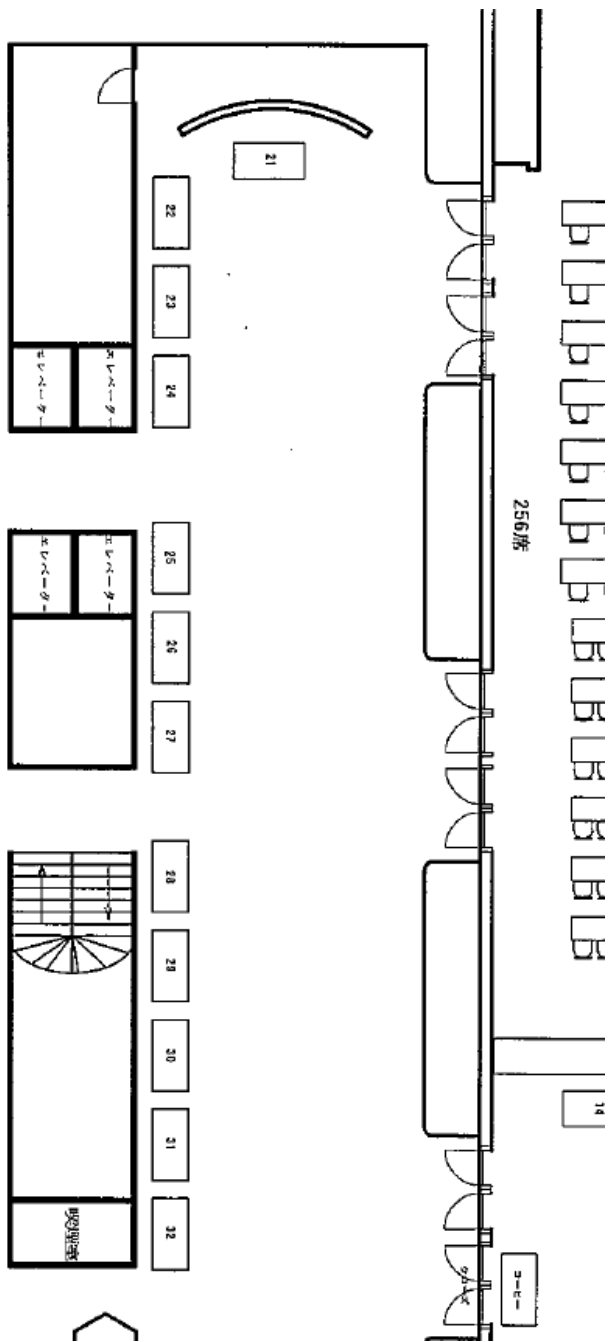
企業展示の場所は、上記、2階平成の間の右1/3（西）とホワイエでございます。企業展示、ポスターセッション、コーヒーサービスと同じ会場です。
ブースレイアウトは以下のページをご参照ください。出展お申込み日、機材関係を検討して事務局にて配置させていただきましたことご了承ください。

9. ブースレイアウト (平安西)



#	出展者名
1	シーメンス EDA ジャパン株式会社
2	シーメンス EDA ジャパン株式会社
3	株式会社 D-process
4	北川グレステック株式会社
5	IEEE EPS
6	株式会社ダイセル
7	東レエンジニアリング株式会社
8	丸文株式会社
9	タツモ株式会社
10	タツモ株式会社
11	株式会社東レサーチセンター
12	積水化学工業株式会社
13	リンテック株式会社
14	住友ベークライト株式会社
15	明電ナノプロセス・イノベーション株式会社
16	キャムテック株式会社
17	ハイソル株式会社
18	ファインテック日本 / TNS システムズ
19	アユミ工業株式会社
20	株式会社図研

10. ブースレイアウト (ホワイエ)



#	出展者名
21	コネクテックジャパン株式会社
22	CKD 株式会社
23	株式会社 SCREEN ホールディングス
24	株式会社東京精密
25	ウシオ電機株式会社
26	株式会社 東設
27	東京応化工業株式会社
28	TOWA 株式会社
29	東北マイクロテック株式会社
30	株式会社 JCU
31	上村工業株式会社
32	ヤマハロボティクスホールディングス株式会社

問い合わせ・お申込みについて

出展に関するお問い合わせ・お申込みは下記にお願いいたします。

IEEE International 3D Systems Integration Conference 2024事務局

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-4 アーバン虎ノ門ビル6F

株式会社セミコンダクタポータル

【 TEL 】 03-6807-3970, 【 FAX 】 03-6807-3960

【E-mail 】 3dic_2024@semiconportal.com